

好德科技股份有限公司

2024年法人說明會

2024年11月26日



免責聲明

本簡報資料所提供資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。

好德科技股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。

議程

- 公司簡介
- 2024 Q3經營績效
- 營運展望
- 問與答

公司簡介

公司基本資料

創立日期

1978年9月

資本額

新台幣6.51億元

員工人數

台灣、大陸及越南地區約105人

上櫃日期

2004年3月 (股票代號3114)

網站

<http://www.howteh.com.tw>

好德集團
服務據點

台北、桃園、香港、深圳、
上海、昆山、北京、越南河內

好德集團
關係企業

台林電通股份有限公司
(股票代號5353)

服務領域

- IT 產業

Information Technology

- 桌上型電腦/筆記型電腦/平板電腦
- 電腦週邊設備

- 通訊產業

Communicate

- 手機應用
- 光纖通訊
- Switches
- Server
- WIFI router
- HDMI

- 光電產業

Photoelectric

- TFT-LCD面板/平面顯示器
- 太陽能/綠能/儲能

- 消費性電子產業

Consumer Electronic

- 液晶顯示器/電視/遙控器
- TWS耳機/智能音箱
- 電動車輛(EV Car, EV Motorcycle)

零件類

服務領域

- 印刷電路板設備PCB
軟板製程設備 FPC

- 半導體 Semiconductor
觸控面板 Touch Panel

- 太陽能產業Solar
綠能產業 Green

設備類
化學材料
Chemical Material

主要供應商與產品

供應商	產品
	日本航空電子 ➤ Connectors , Antenna
	日本住友電工 ➤ Cable
	樓氏電子 ➤ Microphone
	艾為電子 ➤ IC
	銳發科技 ➤ LED Driver IC
	鈺群科技 ➤ IC
	光寶科技 ➤ 光電耦合器、Ambient Light Sensor
	博盛半導體 ➤ MOSFET
	君正科技 ➤ SoC
	Canon Machinery Inc. ➤ 覆晶載板及IGBT基板錫球及奈米銀熱壓機切割機

2024Q3 經營績效

合併損益表

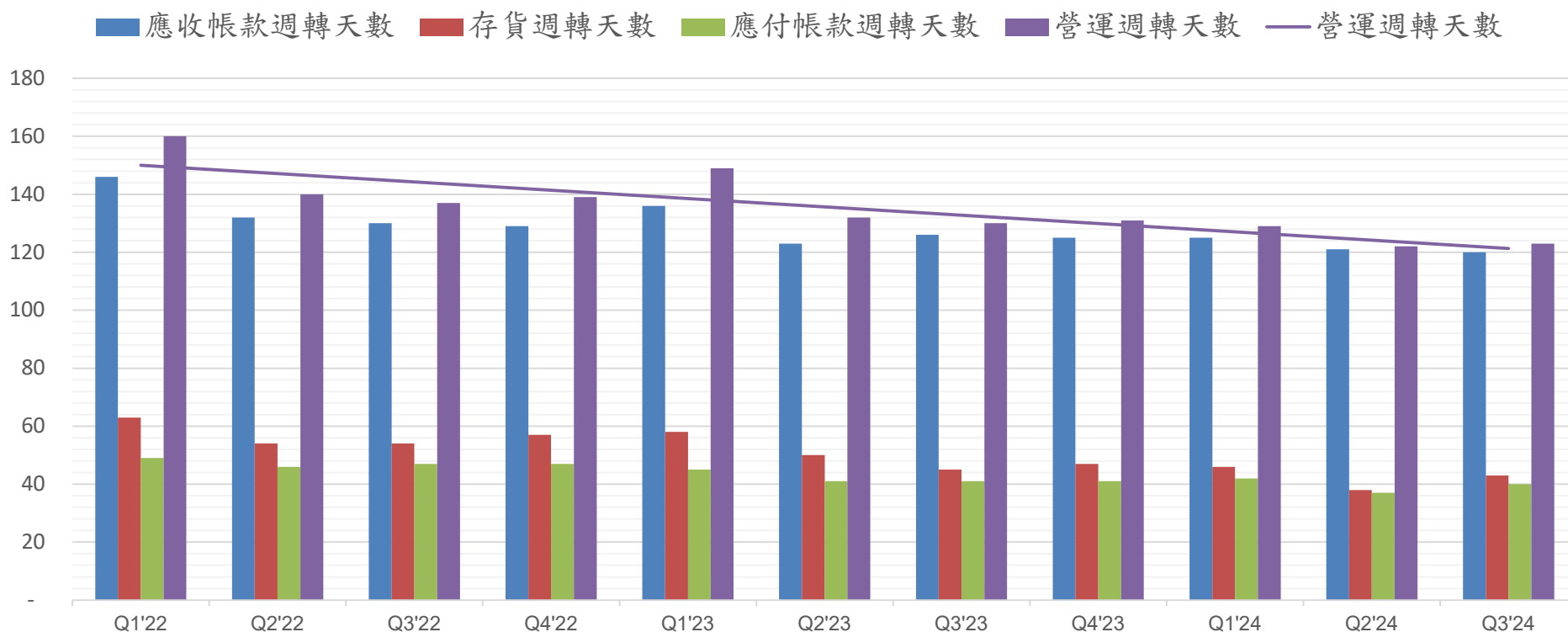
(除另予註明者外，
金額為新台幣仟元)

	3Q'24		2Q'24		QoQ%	3Q'23		YoY%	1Q~3Q'24		1Q~3Q'23		YoY%
營業收入	674,093	100%	707,459	100%	(5%)	771,614	100%	(13%)	2,013,197	100%	2,088,307	100%	(4%)
營業毛利	63,162	9%	71,176	10%	(11%)	87,351	11%	(28%)	192,946	10%	229,689	11%	(16%)
營業費用	(50,436)	(7%)	(55,363)	(8%)	(9%)	(53,102)	(7%)	(5%)	(148,063)	(7%)	(139,165)	(7%)	6%
營業淨利	12,726	2%	15,813	2%	(20%)	34,249	4%	(63%)	44,883	3%	90,524	4%	(50%)
營業外收支	(3,295)	(1%)	13,412	2%	(125%)	44,057	6%	(107%)	44,214	2%	58,817	3%	(25%)
稅前淨利	9,431	1%	29,225	4%	(68%)	78,306	10%	(88%)	89,097	5%	149,341	7%	(40%)
本期淨利	8,971	1%	22,458	3%	(60%)	64,806	8%	(86%)	71,300	4%	117,331	5%	(39%)
每股盈餘(新台幣元)	0.13		0.35			0.99			1.09		1.80		

合併資產負債表

(新台幣仟元)	3Q'24		4Q'23		3Q'23	
流動資產	2,086,990	81%	2,004,477	80%	2,067,487	79%
非流動資產	474,385	19%	515,112	20%	539,193	21%
總資產	2,561,375	100%	2,519,589	100%	2,606,680	100%
流動負債	1,015,554	40%	955,618	38%	965,923	37%
負債	1,024,813	40%	972,720	39%	990,694	38%
權益	1,536,562	60%	1,546,869	61%	1,615,986	62%
流動比	206%		210%		214%	
速動比	168%		182%		188%	
負債比	40%		39%		38%	
每股淨值(元)	23.59		23.75		24.81	

營運資金



營運展望

總體經濟局勢的變化

- ◆ 川普2.0 對於美中台以致於全球政經局勢的衝擊與佈局
- ◆ AI 電腦、手機後續的發展
- ◆ 全球EV car的持續發展
- ◆ 各國生產基地轉移的後續變化

2025年度營運展望

◆ Key accounts持續深耕

- NB 2025預估成長5.6%，除了Knowles 麥克風外，同時推廣博盛MOSFET、君正SoC等新產品。高階機種推廣Knowles高規格(高SNR)、高單價麥克風增加營收。
- Docking 應用隨著Type C的普及後續需求持續成長，SEI TBT cable在Dell、HP與聯想，也是公司持續發展的方向。

◆ 車用市場開發推廣

- 推廣JAE CONN至車用客戶、電動機車。
--應用市場: 充電樁、ADAS、DASH CAM、儲能櫃、IVI /TCU System。
- 博盛Mosfet IC推至新能源車、充電樁。

◆ 新市場開發推廣

- JAE: Gaming、電子標籤、電子書、無人機及智慧家居。
- 艾為及裕太微: 網通及IoT。

2025年度營運展望

◆ 設備部

➤ Canon：

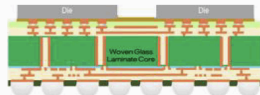
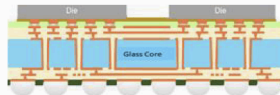
- a). 布局大尺寸載板市場，力推大尺寸板及高良率需求之專用機種，與競爭者做出產品差異，降低競爭風險。
- b). 玻璃基板(Glass Substrate)切割機市場布局。

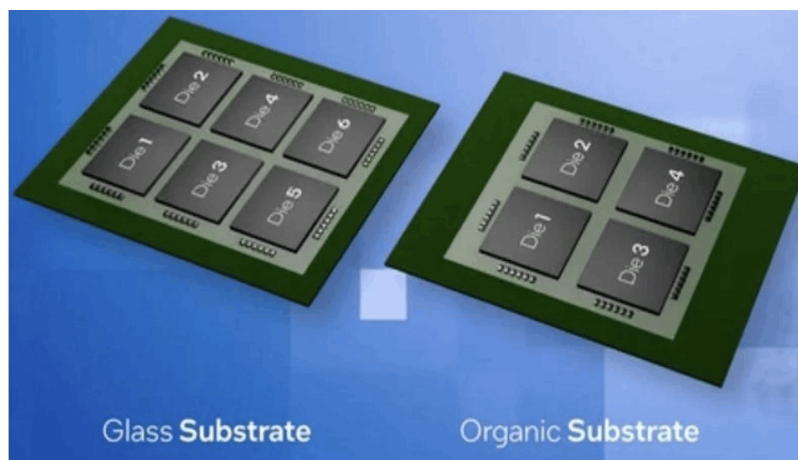
➤ Noritake：

- a). SiC研磨輪產品，除既有客戶外，持續開發潛在客戶。
- b). 搭配均豪精密低Si wafer磨邊機，拓展大陸、日本及東南亞市場。

- 持續尋找新產品，配合半導體市場開展，推廣日本JTEC電漿及電化學技術的SiC、SOI、石英及鑽石晶圓等材質之wafer研磨機。

有機材質基板與玻璃基板比較

結構圖		
生產難度	低	高
信號完整	良好	優秀
成本	低	高
耐溫	較差	較好
尺寸	小	大(100mm*100mm)
關注點	尺寸放大後產生翹曲問題	TGV與玻璃切割時容易產生破裂問題



Q & A